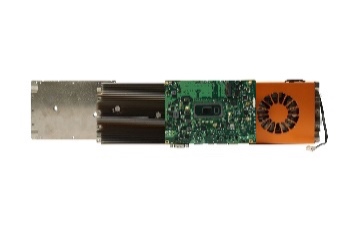
****

|  |  |
| --- | --- |
| **Reader Enquiries:** | **Press Contact:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network** |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Phone: +49-991-2700-0 | Phone: +49-2405-4526720 |
| [info@congatec.com](mailto:info@congatec.com)  [www.congatec.es](http://www.congatec.es) | [info@sams-network.com](mailto:info@prismapr.com)  [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com) |



*Texto y foto también disponible online en:* [*https://www.congatec.com/es/congatec/notas-de-prensa.html*](https://www.congatec.com/es/congatec/notas-de-prensa.html)

**Nota de prensa**

congatec presenta soluciones ultrapotentes de refrigeración para SBC de 3,5 pulgadas

**La masa hace la diferencia**

**Deggendorf/Nuremberg, Alemania, 25 de febrero de 2020 \* \* \*** congatec, proveedor líder de productos informáticos embebidos de alto rendimiento, presenta tres nuevas soluciones premium de refrigeración embebidas para sus ordenadores monoplaca (SBC) de 3.5 pulgadas. Basado en las especificaciones PICMG para los disipadores de calor COM Express estandarizados y gracias a su tamaño extra grande, ofrecen una masa máxima de refrigeración y área de superficie para diseños SBC de 3,5 pulgadas extremadamente potentes. La disipación de calor está estandarizada y todas las soluciones cuentan con un disipador de calor masivo, hecho de metal ligero, que dispersa el calor residual de los puntos calientes de la CPU de manera rápida y efectiva.

Dependiendo del TDP, el disipador térmico se puede expandir con disipadores de calor pasivos con aletas o sistemas de ventilación activa. congatec también ofrece sus tres soluciones de refrigeración en una altura estandarizada, los OEM pueden implementar en el futuro soluciones de refrigeración de huellas idénticas para requisitos de TDP comparables. Esto hará que sea mucho más fácil escalar sistemas embebidos basados ​​en SBC de 3,5 pulgadas a través de múltiples generaciones de procesadores. Las primeras configuraciones de las nuevas soluciones de refrigeración completamente desarrolladas internamente están optimizadas para el uso con los nuevos SBCs de 3,5 pulgadas conga-JC370 basados ​​en la serie de procesadores Intel® Core ™ de 8.a generación (con nombre en código Whiskey Lake).

“Para facilitar a los clientes el diseño de sistemas embebidos, nuestra estrategia siempre ha sido desarrollar soluciones de refrigeración personalizadas y ultrarresistentes para todos nuestros factores de forma, que están estandarizados y, cuando se activa la refrigeración, impresionan con un MTBF extra largo que no solo cumple sino que incluso supera todos los estándares comunes de la industria. Continuando con esta estrategia, ahora también hemos desarrollado una nueva solución de refrigeración única para nuestros SBCs de 3,5 pulgadas. Difiere significativamente de los SBCs convencionales de 3,5 pulgadas, donde el procesador y las E / S están en el mismo lado de la placa. Al montar nuestra solución en la parte inferior de la placa, creamos significativamente más espacio para sistemas de refrigeración masiva, al mismo tiempo que facilitamos a los desarrolladores el diseño de sistemas, ya que la conexión de la carcasa y el flujo de aire del sistema interno están estandarizados”, Afirma Martin Danzer, Director Product Management en congatec, explicando el concepto de refrigeración avanzada para los nuevos SBCs de 3.5 pulgadas, que utilizan casi toda la superficie de la huella de 146 × 102 mm.

Los tres sistemas de refrigeración están diseñados para SBCs de 3,5 pulgadas y se han desarrollado con miras a futuros procesadores que requieran una capacidad de refrigeración de hasta 45 vatios en modos cTDP temporalmente limitados. Consisten en un disipador térmico sin aletas de refrigeración que disipa el calor residual a una carcasa, así como un disipador de calor pasivo con aletas de refrigeración y una variante de refrigeración activa con un ventilador integrado. Cuando se ejecutan altas cargas, se recomienda un ventilador de sistema externo para la variante de refrigeración pasiva. La refrigeración activa está diseñada para un funcionamiento independiente. Para que la integración del sistema sea fácil y flexible, cada una de las soluciones de refrigeración anteriores está disponible en variantes roscadas (threaded) y de pozo (borehole).

El sistema de refrigeración activa basado en ventilador, que se utiliza, por ejemplo, en los sistemas de 3,5 pulgadas con procesadores Intel® Core ™ i7 de octava generación de 25 vatios (i7-8665UE / nombre en clave Whiskey Lake), está específicamente diseñado para funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana en condiciones adversas de ambientes industriales, En este sistema de refrigeración completa, los ventiladores no solo se montan de forma más segura, sino que también se fijan específicamente para reducir el desgaste. Además, los rodamientos están equipados con un sello especial y una cubierta adicional para proporcionar la máxima protección para mecánicos y lubricantes. Con un aceite sintético de alto rendimiento como lubricante, el ventilador tiene un MTBF de varias décadas, y esto en el rango de temperatura industrial desde -45 a + 85 ° C y con resistencia a golpes y vibraciones de grado industrial.

Para obtener más información sobre las soluciones de refrigeración de congatec para el nuevo ecosistema SBC de 3.5 pulgadas, visite: <https://www.congatec.com/en/technologies/35-sbc-based-on-8th-generation-intel-core-mobile-processors.html>

**Sobre congatec**congatec es una compañía de tecnológica en rápido crecimiento que se centra en productos informáticos embebidos. Los módulos informáticos de alto rendimiento se utilizan en una amplia gama de aplicaciones y dispositivos en automatización industrial, electromedicina, transporte, telecomunicaciones y muchos otros mercados verticales. congatec es el líder mundial del mercado en el segmento de módulos CoM con una excelente base de clientes desde empresas nuevas hasta compañías internacionales de primera clase. Fundada en 2004 y con sede en Deggendorf, Alemania, la compañía alcanzó ventas por 133 millones de dólares en 2018. Más información está disponible en nuestro sitio web en [www.congatec.com](http://www.congatec.com) o via [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/455449), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) y [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).

\* \* \*

*Intel and Intel Core are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.*